

RESINES EPOXY MONOCOMPOSANT POUR APPLICATIONS OPTIQUES, COLLAGE STRUCTURAL ET MOULAGE*

REF	RETICULATION Recommandée	DUREE DE VIE Après mélange	VISCOSITE	Tg	DEGRADATION	CHARGE	COEFFICIENT DE DILATATION		RESISTIVITE	UTILISATIONS
							AVANT TG	APRES TG		
E506	1 min à 125°C	3 jours à 4°C	0,4 Pa.S	80-90°C	350-360°C		60-70.10 ⁻⁶ /°C	140-160.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹³ Ω.cm	Enrobage des puces sur cartes à puces-Haut degré de pureté
E506-5	1 h à 135°C	1 mois à 20°C	12 Pa.S	120-135°C	370-390°C		60-80.10 ⁻⁶ /°C	170-190.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹⁷ Ω.cm	Protection des puces silicium - Noire-Haute pureté
E506-7	10 min à 100°C	5 h à 20°C	4 Pa.S	60-70°C	370-390°C		55-65.10 ⁻⁶ /°C	130-160.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹³ Ω.cm	Protection des puces silicium - Haute pureté - Haute résistance à l'humidité
E507-3	5 min à 150°C	24 h à 25°C	22,5 Pa.S	160-170°C	350-370°C	72%	15-25.10 ⁻⁶ /°C	55-65.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹³ Ω.cm	Protection des semi-conducteurs dans le domaine des cartes à puces
E508	5 min à 150°C	6 jours à 20°C	70 Pa.S	145-155°C	> 350°C	75%	18-20.10 ⁻⁶ /°C	65-75.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹³ Ω.cm	Protection des semi-conducteurs dans le domaine des cartes à puces. Recommandée pppour les puces de grandes dimensions
E508HV	5 min à 150°C	5 jours à 20°C	130 Pa.S	145-155°C	> 350°C		23-25.10 ⁻⁶ /°C	85-100.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹³ Ω.cm	Protection des semi-conducteurs dans le domaine des cartes à puces. Utilisée pour former le cordon autour de la puce
E517	30 min à 150°C	1 mois à 20°C	50 Pa.S	70-100°C	330-350°C		25-30.10 ⁻⁶ /°C	55-65.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹³ Ω.cm	Collage et protection des puces en silicium -Haute pureté - Forte conductivité thermique
E518FC	1 min à 150°C	8 h à 25°C	3,5 Pa.S	40-60°C	350-370°C	59%	30-40.10 ⁻⁶ /°C	100-110.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹³ Ω.cm	Protection des semi-conducteurs de type Flip-chip
E519FC	1 min à 150°C	8 h à 25°C	3,5 Pa.S	40-60°C	350-370°C	64%	35-50.10 ⁻⁶ /°C	110-120.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹³ Ω.cm	Protection des semi-conducteurs de type Flip-chip - Norme UL94VO
NEA155	10 min à 150°C	4 mois à 25°C	42 Pa.S	50-60°C	360-380°C	6%	90-100.10 ⁻⁶ /°C	180-200.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹⁵ Ω.cm	Résine thixotrope rouge pour collage de CMS avant passage à la vague

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 17/07/2006

épotecny

9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - e-mail : epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epot